

证券代码：300400

证券简称：劲拓股份

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20220511

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金 朱啸宇
时间	2022年5月11日
地点	深圳市劲拓自动化设备股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理 徐德勇 董事会秘书 张娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况。</p> <p>公司前身起源于二十多年前，于2014年在创业板上市，长期专注于从事专用设备的研发、生产、销售和服务，主要产品有电子热工设备、检测设备、自动化设备、光电显示设备和半导体专用设备。</p> <p>公司为国家级高新技术企业、国家工信部制造业单项冠军产品企业。公司现有员工约1100人，于深圳市自建两个工业园，建筑面积约10万平方米，配备全套生产设施，采取自主生产模式。</p> <p>公司坚持“专注、持久、分享”的企业理念，自上市以来，公司经营稳健，营业收入规模不断提高。2021年实现营业收入9.89亿元，营收规模创历史新高。</p> <p>近三年，公司注重研发投入，2019年至2021年公司研发投</p>

入平均每年约 4800 万元，与 2019 年以前相比有较大幅度的增长。

公司拥有一批稳定的客户群体，累计服务客户 4,000 余家，相关半导体集成电路厂家客户已拓展 10 数家。

二、公司业务发展情况如何？半导体设备方面取得了哪些成果？

董事长/总经理：1、公司在电子热工设备的研发、生产、制造、人员方面已有 20 多年的积累，相关产品已覆盖电子产品 PCB 生产过程中的插件、焊接、检测等多个流程，为客户提供整套零缺陷焊接检测制造系统和解决方案，公司被行业协会授予“SMT 龙头企业”称号。

2、前几年，公司指纹模组封装设备、显示模组封装设备实现量产，标志着公司成功将业务范围扩展至光电显示设备领域。2019 年，公司在国内首家研制出 3D-Lami 贴合设备，突破韩国封锁，并在 2019 年签订了合计约 2 亿元的产品订单，并陆续得到客户验收。

3、近年来，公司顺利研制出部分半导体专用设备，可以分别应用到半导体制造的封测段和硅片制造段。

（1）公司部分半导体热工设备与公司电子热工设备底层“技术同源”，得以让公司顺利将自身热工方面的技术积累扩展至半导体专用设备领域。研制出的一系列半导体热工设备（如半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氮气烤箱等），已向多家半导体封测厂商和半导体器件生产厂商供货。截至目前，部分设备已顺利在多家客户验收并复购。公司设立了控股孙公司思立康发展半导体热工业务。

（2）公司引入成熟的研发团队，结合自身较强的生产制造能力研制出半导体硅片制造设备，已向客户出货，并已得到部分客户认可验收。公司设立了控股孙公司至元发展半导体硅片制造设备业务。

**三、公司目前的半导体设备应用在半导体制造的哪个环节？
是否可以用在晶圆制造段？**

董事长/总经理：半导体制造流程主要有硅片制造、晶圆制造和封装测试三个部分。公司系列半导体热工设备应用在半导体制造的后段封测环节，半导体硅片制造设备应用在前段硅片制造环节。

晶圆制造段的设备由于投入及技术难度较大，目前国内只有一些较大的设备厂进入。以公司的规模体量，我们前期选择适合自己的赛道，攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的主设备，再以相关设备为切入点，配套其他辅助设备，逐步打通前段和后段生产线。未来如果条件成熟，公司不排除汇聚相关资源切入中段生产设备。

四、公司半导体设备的市场前景如何？

董事长/总经理：近年来，国家及各地政府出台多项政策，重点鼓励发展半导体产业，加速推进相关半导体设备的自主可控，同时国内封测厂扩建速度较快，存在较大的国产设备需求，半导体设备有较大的市场空间。

公司半导体热工设备底层技术源于原有的电子热工设备，相关技术、生产和供应链都比较成熟；公司半导体硅片制造设备引入的专业团队，拥有成熟的设备研发制造经验及客户资源。公司具备相关半导体专用设备的国产化供货能力。

五、公司半导体硅片制造设备具体用于硅片制造的哪些环节？客户有哪些？

董事会秘书：公司半导体硅片制造设备受到客户严格的保密条约限制，为避免过早的引起国外竞争对手的关注和打压，现阶段不便公开该设备的具体工艺和客户。

六、公司半导体设备目前订单量和毛利率如何？2022年公司

	<p>半导体设备方面的收入和利润规划？</p> <p>董事长/总经理：截止公司 2022 年一季报披露日，公司在手订单总金额约 4.34 亿元，其中半导体专用设备相关订单占比约 5%左右。已经客户验收的半导体专用设备，毛利高于公司原有电子热工设备。</p> <p>2022 年，国产半导体封装和硅片制造设备为公司战略级业务，资源向有关业务倾斜，持续攻关封测环节和硅片制造环节一些有技术壁垒且国产空白的半导体设备，打通前段和后段生产线，同时拓宽半导体设备的应用领域，如 IGBT、IC 载板、Wafer Bumping、Clip Bonding、FC BGA 等生产制造领域。以期半导体专用设备收入成为公司 2022 年业绩的增量。</p> <p>现场交流结束后，调研人员参观了公司部分半导体专用设备及光电显示设备生产车间。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，参与人员按要求签署了《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	--
日期	2022 年 5 月 11 日